

# 光デバイス用ステム・パッケージ

これらのステム・パッケージは金属とガラスで製作されており気密性及び絶縁性に優れております。

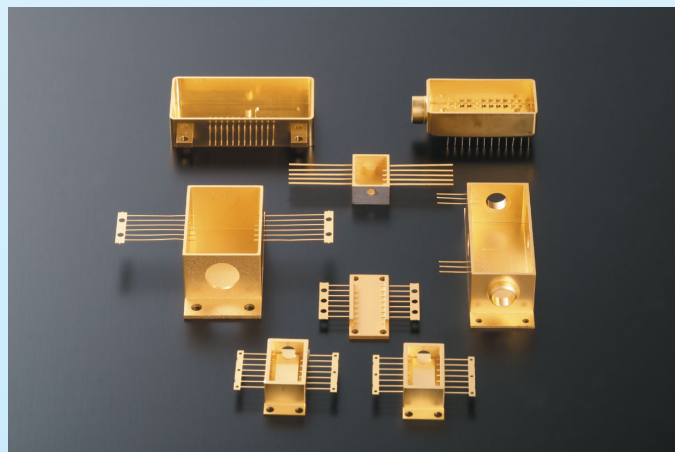
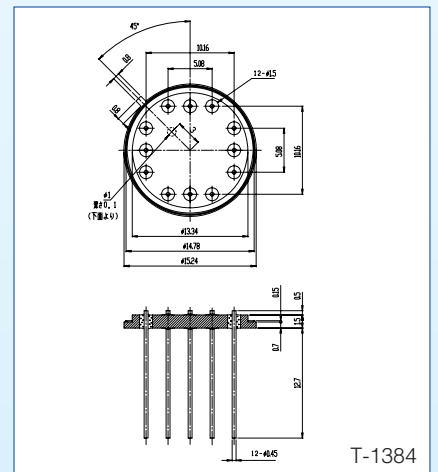
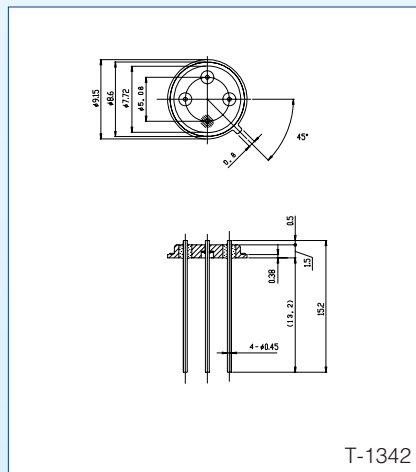
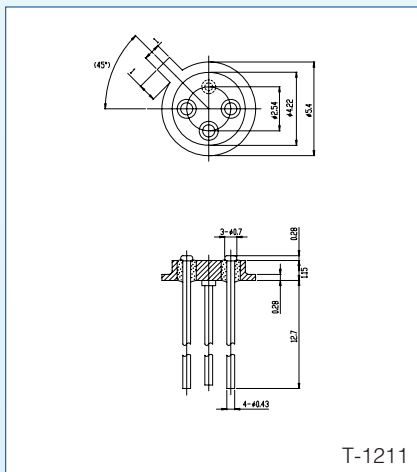
## 主な特徴

- ・気密性： $1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{sec}$ 以下。
- ・絶縁抵抗：1000M 以上。(atDC500V)
- ・仕上げ：Ni-Ep / Ni-EIp+Au-Ep
- ・カバー(キャップ)とセットにしても供給いたします。
- ・代表的概要図を以下に示しておりますが、特注(カスタム)の設計・製作も致しますので、別途ご相談ください。



光デバイス用ステム

## 代表的製品の概略図



光デバイス用パッケージ